Also published as:

US5337063 (A

GB2255692 (A

DE4212808 (A

. ANTENNA CIRCUIT AND S PRODUCTION FOR NON-CONCET TYPE

Patent number:

JP4321190

Publication date:

1992-11-11

Inventor:

TAKAHIRA KENICHI

Applicant:

MITSUBISHI ELECTRIC CORP

Classification:

- international:

G06K19/07; B42D15/10; H01Q1/24; H01Q9/27

- european:

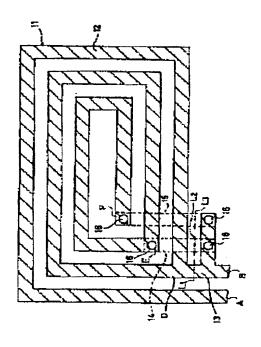
Application number:

JP19910090323 19910422

Priority number(s):

Abstract of JP4321190

PURPOSE:To cope with the change of a carrier frequency and also to attain the matching adjustment of a resonance frequency even after the circuit parts are mounted on a substrate by forming previously plural adjustment patterns and then cutting these patterns except one. CONSTITUTION: A coil 11 contains a spiral main coil 12. A 1st adjustment pattern 13 is formed on a substrate to secure the connection between a part D of a single turn when viewed from an end part A of the voil 12 and the other end B of the coil 12. At the same time, the 2nd and 3rd adjustment patterns 14 and 15 are formed on the back side of the substrate to secure the connection between the end B and the parts E and F of two and three turns when viewed from the end A. These patterns 13-15 are cut except one by the cut lines L1, L2 or L3. Thus the substantial number of turns of the coil 11 can be selected at 1 to 3 times. As a result, the inductance of the coil 11 can be adjusted.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide





(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平4-321190

(43)公開日 平成4年(1992)11月11日

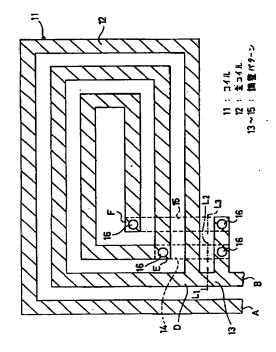
(51) Int.Cl.5		識別記号	庁内整理番号	FΙ			技術表示箇所	
G06K 19	9/07							
B42D 15	5/10	52 1	9111-2C					
H01Q 1	1/24	Z	7046-5 J					
g	9/27		7046-5 J					
			8623-5L	G06K	19/00		Н	
					審査請求	未請求	請求項の数5(全7頁)	
(21)出願番号		特願平3-90323		(71)出願人	順人 000006013 三菱電機株式会社			
(22)出願日		平成3年(1991)4月22日			東京都一	千代田区	丸の内二丁目2番3号	
		·		(72) 発明者	伊丹市理		目1番地 三菱電機株式会	
				(74)代理人	、 弁理士	曾我 3	道照 (外6名)	

(54) 【発明の名称】 非接触型携帯記憶装置のアンテナ回路及びその製造方法

(57)【要約】

[目的] 基板上に回路部品を搭載した後でも搬送波周波数の変更に対応でき且つ共振周波数のマッチング調整を行うことができるようにする。

【構成】基板の周辺部上にスパイラル状の導体パターンからなる主コイル12と、それぞれ主コイル12の対応する巻き数の導体パターンと主コイル12の一端Bとを電気的に接続する複数の調整パターン13、14及び15のうちの一つを残して他の調整パターンを切断することにより所望のインダクタンス特性を得る。





(2)

20



特開平4-321190

1

【特許請求の範囲】

電磁波により外部装置と信号交換を行う 【請求項1】 非接触型携帯記憶装置のアンテナ回路であって、非接触 型携帯記憶装置の基板の周辺部上にスパイラル状に形成 された導体パターンからなる主コイルと、それぞれ主コ イルの対応する巻き数の導体パターンと主コイルの一端 とを電気的に接続すると共にこれらのうち一つを残して 他を切断することにより所望のインダクタンス特性を得 るための複数の調整パターンとを有するコイルと、前記 サとを備えたことを特徴とする非接触型携帯記憶装置の アンテナ回路。

電磁波により外部装置と信号交換を行う 【請求項2】 非接触型携帯記憶装置のアンテナ回路であって、非接触 型携帯記憶装置の基板の周辺部上に形成された導体パタ ーンからなると共にその一部をスパイラル状にトリミン グすることにより所望のインダクタンス特性を得るよう にしたコイルと、前記コイルに接続されて共振回路を形 成するためのコンデンサとを備えたことを特徴とする非 接触型携帯記憶装置のアンテナ回路。

電磁波により外部装置と信号交換を行う 【請求項3】 非接触型携帯記憶装置のアンテナ回路であって、非接触 型携帯記憶装置の基板の周辺部上にスパイラル状に形成 された導体パターンからなるコイルと、それぞれコイル の対応する巻き数の導体パターンとコイルの一端との間 に電気的に接続された複数のスイッチと、前記コイルの 他端に接続されて共振回路を形成するためのコンデンサ とを備えたことを特徴とする非接触型携帯記憶装置のア ンテナ回路。

基板の周辺部上にスパイラル状に導体パ 30 【請求項4】 ターンからなる主コイルを形成し、それぞれ主コイルの 対応する巻き数の導体パターンと主コイルの一端とを電 気的に接続する複数の調整パターンを基板上に形成し、 所望のインダクタンス特性を得るために複数の調整パタ ーンのうち一つを残して他を切断し、主コイルの他端に コンデンサを接続して共振回路を形成することを特徴と する非接触型携帯記憶装置のアンテナ回路の製造方法。

【請求項5】 基板の周辺部上に形成された導体パター ンを形成し、導体パターンのインダクタンスを計測しな がら所望のインダクタンスとなるまで導体パターンの一 部をスパイラル状にトリミングしてコイルを形成し、コ イルの一端にコンデンサを接続して共振回路を形成する ことを特徴とする非接触型携帯記憶装置のアンテナ回路 の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】この発明は、非接触型携帯記憶装 置のアンテナ回路及びその製造方法に関する。

【従来の技術】近年、ICカード等の携帯記憶装置の中 50

で、電磁波及び光等の空間伝送媒体を用いて信号の授受 を行う非接触型携帯記憶装置が利用されつつある。この 種の非接触型携帯記憶装置の構成を図5に示す。記憶装 置の動作を制御するCPU1にパス8を介してROM2 及びRAM3が接続されている。バス8には外部装置 (図示せず) とのデータの入出力を制御する入出力制御 回路4が接続され、入出力制御回路4には変復調回路5 を介してアンテナ回路6が接続されている。さらに、記 憶装置内の各電気回路に電源を供給するための電池7が コイルに接続されて共振回路を形成するためのコンデン 10 内蔵されている。このような記憶装置では、端末機等の 外部装置からの電磁波によるコマンド信号がアンテナ回 路6で受信されると、このコマンド信号は変復調回路5 で復調された後、入出力制御回路4を介してCPU1に 入力される。CPU1はコマンド信号を解読し、所定の 応答信号を作成する。この応答信号は入出力制御回路4 を介して変復調回路5に入力され、ここで変調された 後、アンテナ回路6から外部装置に発信される。

2

【0003】実際には、図6に示されるように、CPU 1、ROM2、RAM3、入出力制御回路4、変復調回 路5及びパス8は一つのIC9内に集積され、このIC 9及び電池7等がカード基板10上に搭載される。ま た、電磁波により外部装置と信号交換を行うアンテナ回 路6は、カード基板10の周辺部上にスパイラル状に形 成された導体パターン61からなるインダクタンスしの コイル62とカード基板10上に搭載されたキャパシタ ンスCのコンデンサ63とを有している。これらのコイ ル62とコンデンサ63は、図7に示されるように、L C直列共振回路を形成しており、その共振周波数付近の 周波数を有する電磁波により共振回路上に誘導される電 圧が検出され、これにより受信が行われる。この場合、 アンテナ回路6により受信することのできる電磁波の周 波数は、LC直列共振回路の共振周波数 fo=1/{2 π (L·C) 1/2 } で決定される。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、図6に 示したように、アンテナ回路6のコイル62は導体パタ ーンとしてカード基板10の周辺部上に形成されるの で、コイル62のインダクタンスLはカード基板10の 製造時に決定されてしまい、その後インダクタンスLを 変更することはできなかった。その結果、信号交換のた めの搬送波の周波数の変更に対応することができず、ま たカード基板10の製造後に共振周波数のマッチング調 整を十分に行うことができないという問題があった。

【0005】この発明はこのような問題点を解消するた めになされたもので、基板上に回路部品を搭載した後で も搬送波周波数の変更に対応でき且つ共振周波数のマッ チング調整を行うことができる非接触型携帯記憶装置の アンテナ回路を提供することを目的とする。また、この 発明はこのような非接触型携帯記憶装置のアンテナ回路 を得ることができる製造方法を提供することも目的とし

40

(3)

ている。

[0006]

【課題を解決するための手段】請求項1に係る非接触型携帯記憶装置のアンテナ回路は、基板の周辺部上にスパイラル状に形成された導体パターンからなる主コイルと、それぞれ主コイルの対応する巻き数の導体パターンと主コイルの一端とを電気的に接続すると共にこれらのうちーつを残して他を切断することにより所望のインダクタンス特性を得るための複数の調整パターンとを有するコイルと、このコイルに接続されて共振回路を形成す 10 るためのコンデンサとを備えたものである。

3

【0007】また、請求項2に係るアンテナ回路は、基板の周辺部上に形成された導体パターンからなると共にその一部をスパイラル状にトリミングすることにより所望のインダクタンス特性を得るようにしたコイルと、このコイルに接続されて共振回路を形成するためのコンデンサとを備えたものである。

【0008】 請求項3に係るアンテナ回路は、基板の周辺部上にスパイラル状に形成された導体パターンからなるコイルと、それぞれコイルの対応する巻き数の導体パターンとコイルの一端との間に電気的に接続された複数のスイッチと、コイルの他端に接続されて共振回路を形成するためのコンデンサとを備えたものである。

【0009】さらに、請求項4に係るアンテナ回路の製造方法は、基板の周辺部上にスパイラル状に導体パターンからなる主コイルを形成し、それぞれ主コイルの対応する巻き数の導体パターンと主コイルの一端とを電気的に接続する複数の調整パターンを基板上に形成し、所望のインダクタンス特性を得るために複数の調整パターンのうち一つを残して他を切断し、主コイルの他端にコン30デンサを接続して共振回路を形成する方法である。

【0010】請求項5に係るアンテナ回路の製造方法は、基板の周辺部上に形成された導体パターンを形成し、導体パターンのインダクタンスを計測しながら所望のインダクタンスとなるまで導体パターンの一部をスパイラル状にトリミングしてコイルを形成し、コイルの一端にコンデンサを接続して共振回路を形成する方法である。

[0011]

【作用】請求項1のアンテナ回路では、複数の調整パタ 40 ーンがインダクタンス特性調整のために設けられており、これら調整パターンのうち一つを残して他の調整パターンを切断することによりインダクタンス特性が調整される。請求項2のアンテナ回路では、導体パターンの一部をスパイラル状にトリミングすることによりインダクタンス特性が調整される。請求項3のアンテナ回路では、複数のスイッチのうち一つをオンさせると共に他のスイッチをオフさせることによりインダクタンス特性が調整される。請求項4の製造方法では、複数の調整パターンのうち一つを残して他の調整パターンを切断するこ 50

とにより所望の特性を有するアンテナ回路を製造する。 請求項5の製造方法では、導体パターンのインダクタン スを計測しながら導体パターンの一部をスパイラル状に

トリミングすることにより所望の特性を有するアンテナ

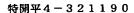
回路を製造する。 【0012】

【実施例】以下、この発明の実施例を添付図面に基づい て説明する。図1にこの発明の第1の実施例に係る非接 **触型携帯記憶装置のアンテナ回路のコイル11を示す。** この図1はコイル11を模式的に示したもので、実際に は図6に示したようにカード基板の周辺部上に形成さ れ、コイル11の内側にIC、電池等の部品が配置され る。このコイル11は基板上に3回巻きのスパイラル状 に形成された導体パターンからなる主コイル12を有し ている。主コイル12の端部Aからみて1回巻きの部分 Dと主コイル12の他端部Bとを接続する第1の調整パ ターン13が基板上に形成されている。また、主コイル 12の端部Aからみて2回巻きの部分Eと主コイル12 の他端部Bとを接続する第2の調整パターン14が基板 の裏面上に形成され、この調整パターン14と主コイル 12とがスルーホール16を介して電気的に接続されて いる。さらに、主コイル12の端部Aからみて3回巻き の部分Fと主コイル12の他端部Bとを接続する第3の 調整パターン15が基板の裏面上に形成され、この調整 パターン15と主コイル12とがスルーホール16を介 して電気的に接続されている。

【0013】これら三つの調整パターン $13\sim15$ のうちーつをそのまま残すと共に他の調整パターンを切断線 11、12あるいは13で切断することにより、コイル11の実質的な巻き数を1回から3回までの間で選択することができる。例えば、調整パターン13を残して他の調整パターン14及び15を切断すれば1回巻きのコイル11となり、同様にして調整パターン14を残せば2回巻き、調整パターン15を残せば3回巻きのコイル11となる。一般にコイルのインダクタンスしは、コイルの巻き数12との間に120関係を有している。ここで、131の形状により決定される定数である。従って、コイル111の実質的な巻き数を変えることにより、コイル111のインダクタンスしを調整することができる。

[0014] なお、コイル11の一端部Aには図6及び図7に示したようにキャパシタンスCのコンデンサが接続され、このコンデンサとコイル11とによりLC直列共振回路からなるアンテナ回路が形成される。この実施例のアンテナ回路では、基板上に回路部品を搭載した後でも、調整パターン13~15の選択により、搬送波周波数の変更に対応することができ、また共振周波数のマッチング調整を行うことが可能となる。

【0015】このようなアンテナ回路は、次のようにし で製造することができる。すなわち、基板の周辺部上に





5

Ş

スパイラル状に導体パターンからなる主コイル12を形成する一方、主コイル12の部分D~Fと端部Bとをそれぞれ接続する調整パターン13~15を形成する。次に、所望のインダクタンス特性が得られるように、これら調整パターン13~15のうち一つのパターンを残して他のパターンを切断する。この調整パターンの切断は、例えばパターンへのレーザビームの照射、サンドによるパターンの切削、化学的エッチング等の方法により行うことができる。さらに、主コイル12の端部Aにコンデンサを接続して共振回路を形成する。

【0016】なお、主コイル12の端部Aへのコンデンサの接続を、調整パターンの切断に先立って行ってもよい。また、図1では模式的に3回巻きの主コイル12を示したが、これに限るものではなく、実際には数十回巻きの主コイルが用いられる。これに伴って、調整パターンも三つに限らず、それ以上の調整パターンを形成することもできる。

【0017】この発明の第2の実施例に係るアンテナ回 路のコイル17を図2に示す。この図2は図1と同様に コイル17を模式的に示したもので、実際には図6に示 20 したようにカード基板の周辺部上に形成され、コイル1 7の内側にIC、電池等の部品が配置される。このコイ ル17は基板上に形成されると共にその一部がスパイラ ル状にトリミングされた導体パターン18を有してい る。導体パターン18の最も内側の部分Gはスルーホー ル19及び基板裏面に形成された接続パターン20を介 して基板表面の端部パターン21に電気的に接続されて いる。導体パターン18は、位置e1からスパイラル状 に位置e2までトリミングされているが、このトリミン グの終了位置 e 2を変えることにより、コイル17の実 30 質的な巻き数が変化し、これによりコイル17のインダ クタンス特性を調整することができる。図2において、 一点鎖線はさらにトリミングする際のパターンラインを 示している。

【0018】なお、コイル17の一端部HあるいはJには図6及び図7に示したようにキャパシタンスCのコンデンサが接続され、このコンデンサとコイル17とによりLC直列共振回路からなるアンテナ回路が形成される。この第2の実施例のアンテナ回路においては、基板上に回路部品を搭載した後でも、導体パターン18をさ40らにトリミングすることにより、搬送波周波数の変更に対応することができ、また共振周波数のマッチング調整を行うことが可能となる。

【0019】このようなアンテナ回路は、次のようにして製造することができる。すなわち、基板の周辺部上に図3に示すように幅広の環状の導体パターン18を形成する一方、導体パターン18の部分Gに接続される接続パターン20及び端部パターン21を形成する。次に、図示しないインダクタンス測定装置により導体パターン18の端部Hと端部パターン21の端部Jとの間のイン50

ダクタンスを計測しつつ、計測値が所望の値となるまで位置 e 1 からスパイラル状に導体パターン 1 8 をトリミングする。このとき、トリミングされずに残された導体パターンの幅が一定となるようにトリミングを行う。このようにしてトリミングを進めると、端部H及びJからみたコイル 1 7 の そうを数は次第に増加し、その結果コイル 1 7 のインダクタンス L も増加する。そして、所望の値のインダクタンスとなったところでトリミングを終了する。さらに、導体パターン 1 8 の端部HあるいはJにコンデンサを接続して共振回路を形成する。

6

【0020】なお、コンデンサの接続を、導体パターン18のトリミングに先立って行ってもよい。このようにしてアンテナ回路を製造すれば、コイル17のインダクタンスを計測しながら導体パターン18のトリミングを行うので、極めて高精度にインダクタンスの調整をすることができる。

【0021】この発明の第3の実施例に係るアンテナ回路を図4に示す。インダクタンスLのコイル22の一端とキャパシタンスCのコンデンサ23の一端とが互いに接続されてLC共振回路を形成している。コイル22は、ソレノイドコイルの形状に形成され、所定の巻き数の箇所P、Q及びRにそれぞれスイッチS1、S2及びS3の一端が接続され、これらのスイッチS1、S2及びS3の他端が互いに接続されてコイル22の他端を形成している。スイッチS1、S2及びS3のうち一つをオン状態にすると共に他のスイッチをオフ状態にすることにより、コイル22の実質的な巻き数を3段階に変えることができる。その結果、共振回路のインダクタンスを調整することができる。

【0022】なお、図1に示した第1の実施例と同様に 基板の周辺部上にスパイラル状の導体パターンからなる コイルと複数の調整パターンとを形成し、各調整パターンにそれぞれ調整パターンを導通/遮断させるスイッチを設けることにより、この第3の実施例を実現することができる。スイッチS1、S2及びS3としては、例えば半導体アナログスイッチを用いることができる。また、スイッチは三つに限るものではない。

【0023】この第3の実施例では、スイッチS1、S2及びS3を非接触型携帯記憶装置に内蔵されているCPU(図示せず)からの制御信号によってオン/オフ制御することができる。すなわち、CPUを制御するプログラムにより、アプリケーションの中で自由にコイル22の実質的なインダクタンスを変更させることが可能となる。

[0024]

【発明の効果】以上説明したように、請求項1に記載の非接触型携帯記憶装置のアンテナ回路は、基板の周辺部上にスパイラル状に形成された導体パターンからなる主コイルと、それぞれ主コイルの対応する巻き数の導体パターンと主コイルの一端とを電気的に接続すると共にこ



れらのうち一つを残して他を切断することにより所望の インダクタンス特性を得るための複数の調整パターンと を有するコイルと、このコイルに接続されて共振回路を 形成するためのコンデンサとを備えているので、基板上 に回路部品を搭載した後でも搬送波周波数の変更に対応 でき且つ共振周波数のマッチング調整を行うことが可能 となる。また、請求項2及び3に記載のアンテナ回路に おいても同様の効果が得られる。

【0025】請求項4に記載の非接触型携帯記憶装置の アンテナ回路の製造方法は、基板の周辺部上にスパイラ 10 す平面図である。 ル状に導体パターンからなる主コイルを形成し、それぞ れ主コイルの対応する巻き数の導体パターンと主コイル の一端とを電気的に接続する複数の調整パターンを基板 上に形成し、所望のインダクタンス特性を得るために複 数の調整パターンのうち一つを残して他を切断し、主コ イルの他端にコンデンサを接続して共振回路を形成する ので、基板上に回路部品を搭載した後でも搬送波周波数 の変更に対応でき且つ共振周波数のマッチング調整を行 うことのできるアンテナ回路が得られる。また、請求項 5に記載の製造方法においても請求項4の方法と同様の 20・18 効果が得られる。

【図面の簡単な説明】

【図1】この発明の第1の実施例に係る非接触型携帯記 憶装置のアンテナ回路のコイルを模式的に示す平面図で ある。

【図2】第2の実施例に係るアンテナ回路のコイルを模 式的に示す平面図である。

【図3】図2のアンテナ回路を製造する際の初期の導体 パターンを模式的に示す平面図である。

【図4】第3の実施例に係るアンテナ回路を示す回路図 である。

【図5】従来の非接触型携帯記憶装置の構成を示すプロ ック図である。

【図 6 】図 5 の非接触型携帯記憶装置の機械的構造を示

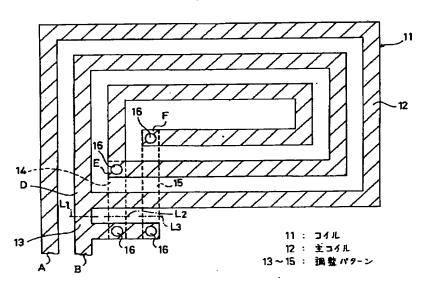
【図7】図5の非接触型携帯記憶装置におけるアンテナ 回路を示す回路図である。

【符号の説明】

- 1 1 コイル
- 12 主コイル
- 調整パターン 13
- 調整パターン 14
- 15 調整パターン
- 17 コイル
- 導体パターン
 - 22 主コイル
 - 23 コンデンサ
 - スイッチ S 1
 - S 2 スイッチ
 - スイッチ S 3

【図1】

(5)

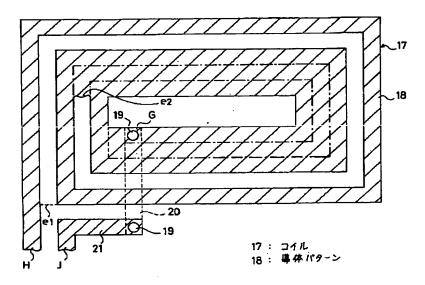




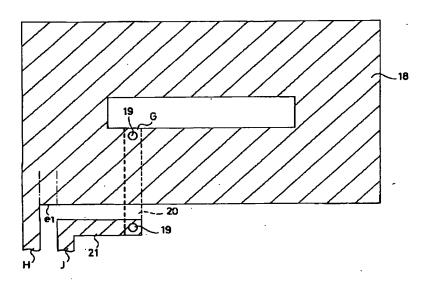


【図2】

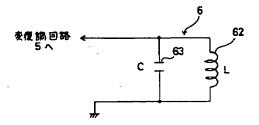
(6)



【図3】



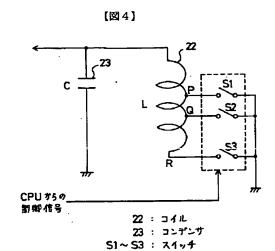
【図7】

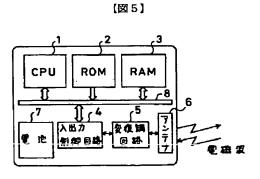






(7)





71 - **3**5 - 7(17)

【図6】

